

证券代码：300480

证券简称：光力科技

## 光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260512

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	招商基金；华安基金；中银基金；华宝信托；东方红；农银汇理；长信基金；国联安；国金基金；太平基金；财通基金；东吴基金；摩根士丹利；银叶投资；鸿富基金；上海仙人掌私募；江信基金；荣信泰私募；上海道涵私募；苏州红方红资管；鑫融长弘；上海兆魏投资；杭州赛福投资；华泰证券；国泰海通投资。
时间	2026年5月9日、5月11日-12日
地点	公司郑州航空港厂区2号楼会议室、上海
上市公司接待人员姓名	总经理、董事：胡延艳 董事会秘书：吕琦 证券事务代表：关平丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍了公司2025年度及2026年第一季度业绩情况，部分投资者实地参观了公司生产车间和展厅区域；公司参加了2026年5月12日华源证券策略会，并就投资者关注的问题进行交流。主要交流内容如下：</p> <p><b>1、公司半导体业务在一季度实现扭亏为盈，未来盈利能力能继续保持并进一步提升吗？</b></p> <p>答：目前半导体行业处于上行周期，预期公司半导体业务可延续2025年下半年以来的良好趋势。公司将紧跟行业发展趋势，围绕客户需求持续技术创新、产品迭代，不断推进精益生产、降本增效，确保公司盈利能力的稳步提升。</p> <p><b>2、半导体业务自2025年7月起快速增长，目前大客户订单占公司国内半导体业务新增订单的一半左右，是否存在单一客户依赖风险？</b></p>

答：公司半导体封测装备业务根据区域分为国内半导体业务和海外半导体业务。虽然目前大客户订单占到国内半导体新增订单的一半左右，但公司半导体业务客户众多，历年来不存在单一客户营收占比超过50%的情况。目前不存在单一客户依赖风险。

**3、当前公司产能利用率如何？航空港厂区二期预计什么时候投产，投产后整体产能将提升多少？**

答：公司国产半导体设备产能目前处于满产状态；公司在全力加紧航空港厂区二期产能扩建项目的建设，预计在2027年一季度建筑工程全部完工，二期规划产能是现有产能的三倍以上。

**4、在先进封装领域，公司产品与国内外竞争对手相比，在切割精度、效率或良率方面有何差异？**

答：公司国产半导体机械划切设备在切割品质和切割效率等方面均可与国际头部对标型号相媲美，已经得到包括国内头部封测企业等客户的广泛认可和批量复购。

划片机是半导体后道封装工艺的关键设备之一，其切割精度和切割良率将直接影响客户产品的性能和成本。客户选择国内设备供应商时，直接对标进口设备的性能参数和工艺标准。

**5、机械划片机和激光划片机各自的应用场景是哪些，激光划片机会替代机械划片机吗？**

答：机械划片机通用性比较强，可以适配大多数场景下的划切需求，也是目前行业内使用最多的切割方式；激光开槽机主要用于Low-k薄膜、氮化铝、氧化铝陶瓷等材料的加工；激光隐切机主要用于对颗粒沾污、加工负荷承载要求比较高的工件（如超薄硅晶圆、MEMS器件等）以及硬脆材料（如第三代半导体器件）等的切割。

激光划片机和机械划片机在不同的划切工序或应用场景都有各自的优劣势，两者主要是互补关系。

**6、公司新产品进度如何，预计什么时候可以形成订单？**

答：公司激光开槽机、研磨机、硬刀等产品目前正在客户端验证；激光隐切机已试切多批客户样片；国产化软刀已有部分型号实现批量供货，国产空气主轴已经批量应用于半导体切割、研磨、硅片生产、光学

	<p>检测和接触式透镜行业的金刚石车削等设备;研磨抛光一体机正在进行研发样机的功能性测试,公司将全力加快新产品的验证进度,并尽快形成销售订单。</p> <p><b>7、子公司 ADT 的经营是否受中东局势影响? 商誉是否存在减值风险?</b></p> <p>答: 2026 年第一季度 ADT 受物流运输影响设备交付有所延迟, 耗材业务保持稳定; 目前 ADT 生产经营正常, 厂房、设备及人员均安全。后续公司航空港厂区二期产能扩建项目建设完成, 郑州工厂将为 ADT 子公司提供生产协同, 保证客户订单的交付, 最大限度降低外部环境对客户的影响。公司将持续跟踪局势变化, 充分与相关各方紧密沟通, 全力守护海外员工安全与产业供应链稳定。</p> <p>子公司目前在手订单同比环比增长都较大, 目前商誉为 1.67 亿, 随着半导体行业的复苏和子公司所在地域形势逐步稳定, 公司订单执行率将得到提升, 预计在未出现重大变化的情况下, 商誉减值的风险较小。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 12 日